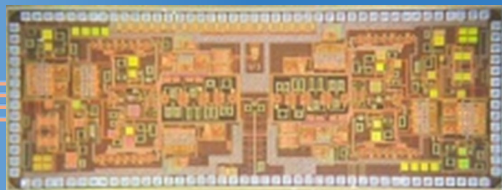


MMIC Solutions Core Chip

SSPA(Solid State Power
Amplifier)

製品の特長

本製品（Core Chip）は、アクティブ・フェーズド・アレイ・システム向けに、使いやすさ、性能、SWaP（サイズ、重量、消費電力）の低減、そしてコスト削減を追求し、CMOSベースのMMICソリューションを実現しております。アクティブ・フェーズド・アレイ用TRMの全コンポーネント、さらにはマルチチャンネルTRMまでを、コアチップと呼ばれる単一の基盤に統合することを目指しています。

製品ラインナップ

Item	Description	Performance	Size (mm)	Package Type
RMF020035PB	S-Band Core Chip	- Operation Frequency: 2.0~3.5 GHz - Gain: 6 dB - Phase(6-bit): 360° (5.625° step) - Attenuation(6-bit): 31.5 dB (0.5 dB step)	5.0 x 5.0	QFN
RMF050065PB	C-Band Core Chip	- Operation Frequency: 5.0~6.5 GHz - Gain: 8 dB - Phase(6-bit): 360° (5.625° step) - Attenuation(6-bit): 31.5 dB (0.5 dB step)	5.0 x 5.0	QFN
RMF053055PD2CH	2 Channel C-Band Core Chip	- Operation Frequency: 5.3~5.5 GHz - Tx/Rx Gain: 10.5/3.0 dB - Phase(6-bit): 360° (5.625° step) - Attenuation(6-bit): 31.5 dB (0.5 dB step)	6.5 x 4.5	QFN
RMF080100PD4CH	4 Channel X-Band Core Chip	- Operation Frequency: 8.0~10.0 GHz - Tx Gain: 12 dB - Rx Gain: -9 dB - Phase(6-bit): 360° (5.625° step) - Attenuation(5-bit): 31.0 dB (1.0 dB step)	10.0 x 5.0	QFN
RMF090100PD4CH	4 Channel X-Band Core Chip	- Operation Frequency: 9.0~10.0 GHz - Tx Gain: 12 dB - Rx Gain: 4 dB - Phase(6-bit): 360° (5.625° step) - Attenuation(5-bit): 31.0 dB (1.0 dB step)	10.0 x 5.0	QFN